


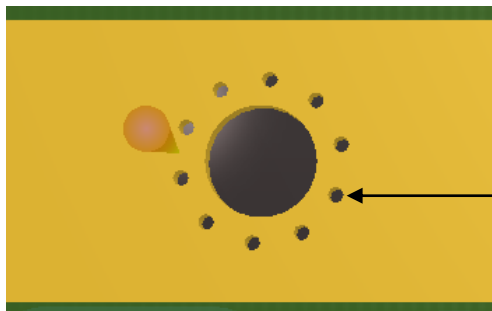
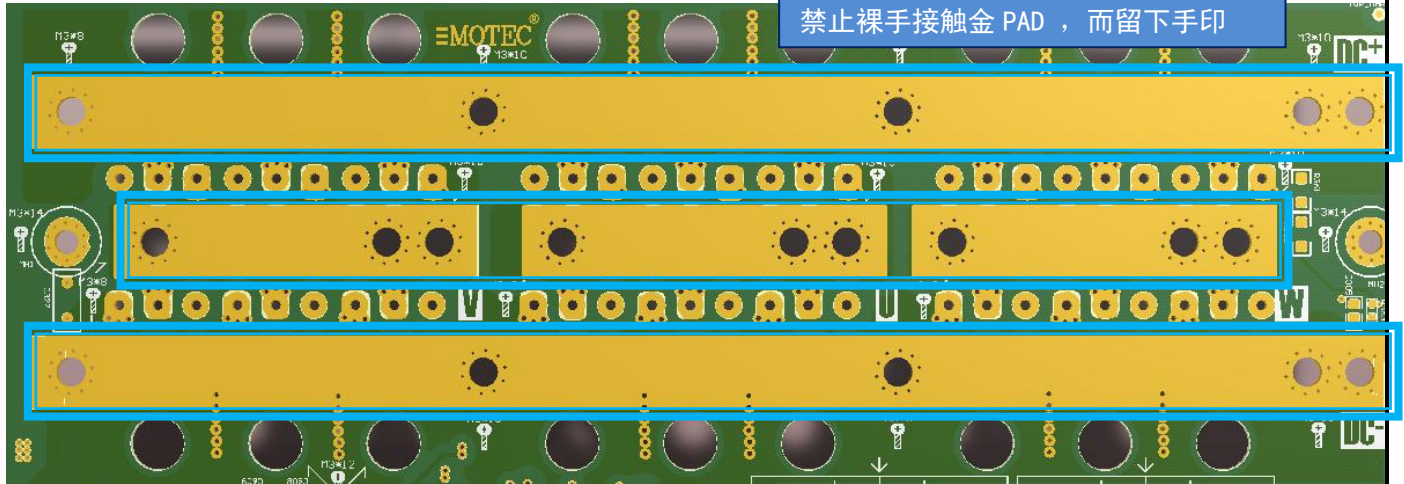
PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	CROCO_V6	焊接	QM033200330	V6	1/2	20200330

一、MAIN 主板焊接要求

1 铜排结合区域要求

- 1) 下图  框内金 PAD 区域严禁沾锡
- 2) 洗板水不能污染金 PAD

图示的金 PAD 区域, 焊接前首先使用高温胶带覆盖保护住, 禁止任何沾锡; 后期也要注意洗板时, 不能污染金 PAD 禁止裸手接触金 PAD, 而留下手印

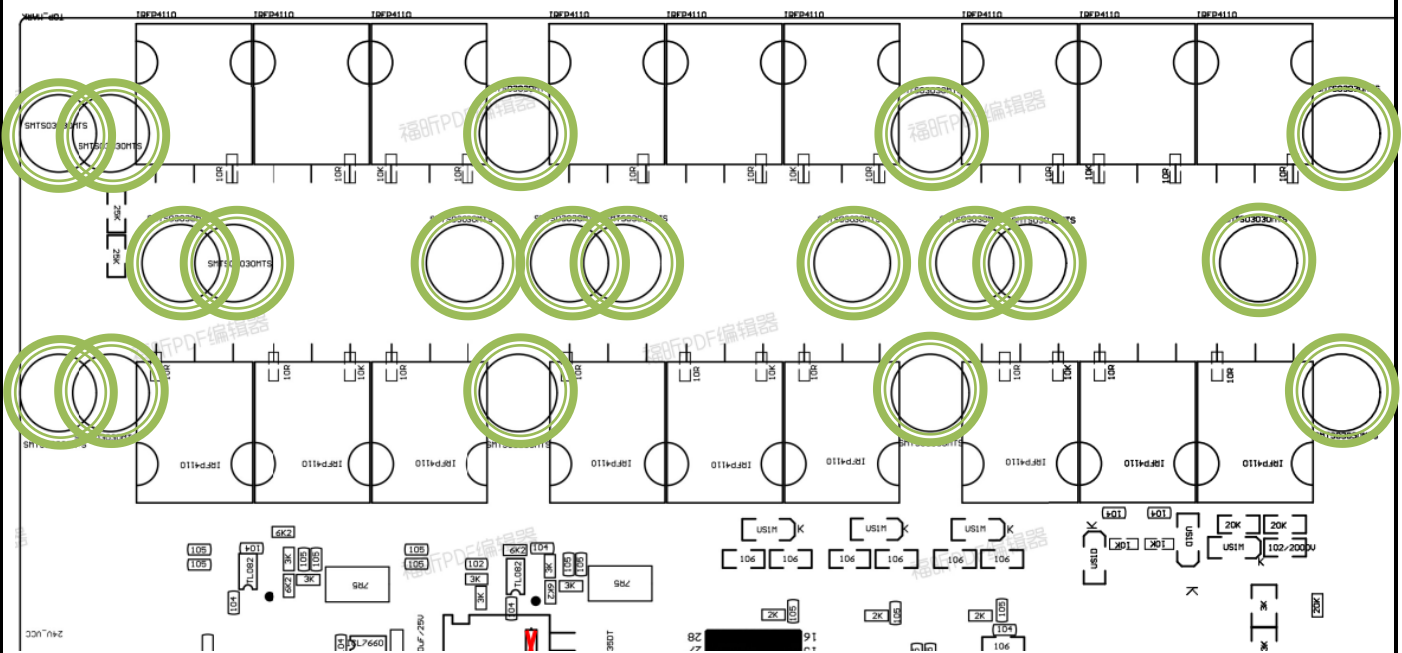


图示类似位置焊接贴片螺母(在底层), 焊接时漏锡到此面(顶层), 只要其漏锡不超过顶层面, 禁止沾锡污染金 PAD

2. 贴片螺母均贴装在底层



SMTS03030MTS (红色字符为高度: 030 为 3mm 高)

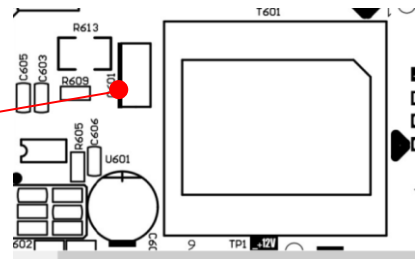
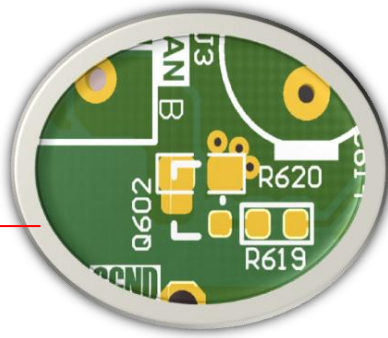
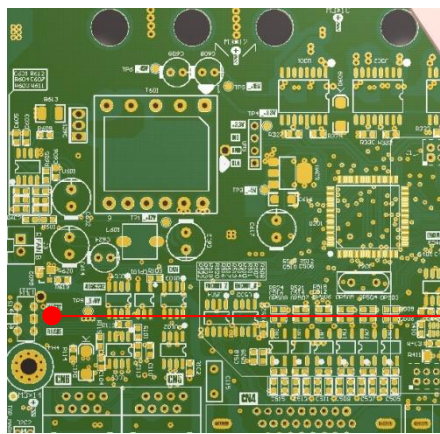


注意事项:

- 1) 贴片螺母焊接要求不能歪斜, 必须垂直于 PCB 落到底部焊接;
- 2) 贴片螺母保证完全与 PCB 接触焊接 (禁止浮高);

PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	CROCO_V6	焊接	QM033200330	V6	2/2	20200330

3. CROCO_MAIN_V6 图示位置贴装 R620 贴装 0805 封装的 0 欧姆电阻, Q602 不焊接

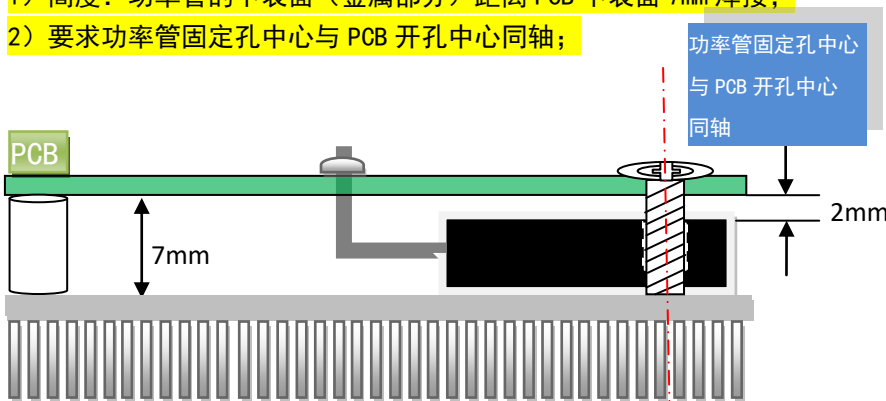


4. Q601 元件焊接要求:

注意 Q601 的焊接方向, 右图粗线标识为其金属散热体部分

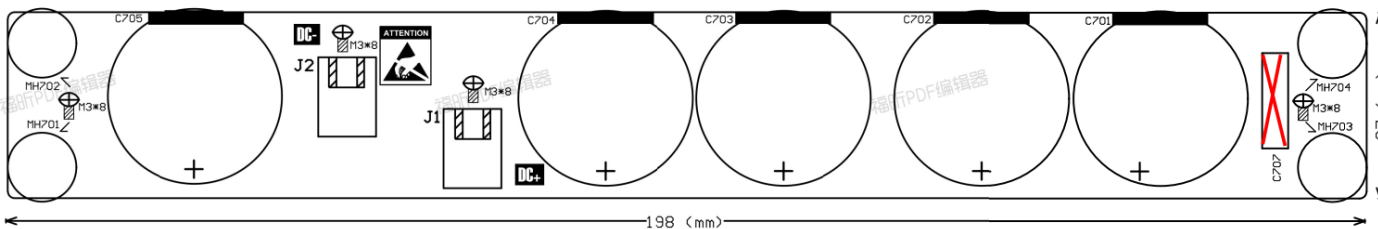
5. 功率管 Q301~Q318 共计 18 个 (T0-247 封装的管子) 及 U202 (T0-220 封装的管子) 焊接要求:

- 1) 高度: 功率管的下表面 (金属部分) 距离 PCB 下表面 7mm 焊接;
- 2) 要求功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴;



6. 滑动开关 S1, 洗板时, 不要进入液体, 否则会影响使用
未做说明的所有元件均紧贴焊接

二、ADD1 (电容板焊接要求)



- 1. J1 和 J2 PCB 连接件确保焊接落位到底, 且保证元件本体垂直于电容板, 禁止浮高及虚焊现象
- 2. 电容管脚确保焊接良好, 禁止虚焊
- 3. 所有插件的管脚剪切后长度不能超过 1.5mm (PCB 基准面算起的高度)

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	